

证券代码：688981

证券简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他（ ）
参与单位名称	华泰证券、中信证券、中金公司、东方证券、国泰海通证券、中信里昂证券、国海证券及通过电话和网络参加会议的各界人士。根据业绩说明会平台统计，电话拨入和平台连接合计共有869位投资者。
时间	2026 年 8 月 14 日
地点	网络/电话会议
公司接待人员姓名	联合首席执行官赵海军博士、资深副总裁兼董事会秘书郭光莉女士、资深副总裁兼财务负责人吴俊峰博士
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	中芯国际（证券代码：00981.HK/688981.SH）是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供 8 英寸和 12 英寸晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于中国上海，拥有全球化的制造和服务基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座 8 英寸和 12 英寸晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务。 详细资讯请参考中芯国际网站 www.smics.com。
交流问答	（在此提醒各位，我们今天的表述，包括了前瞻性陈述，是对公司未来业绩的预期，而非保证，并受固有风险和不确定因素的影响。请参阅我们业绩公告中的前瞻性陈述。除非另有说明，业绩说明会的数据根据国际财务报告准则来表述，货币以美元表示。） ■ 资深副总裁、财务负责人吴俊峰博士发言： 大家好。首先，我向大家汇报 2026 年第二季度及上半年未经审核业绩，然后给出第三季度指引。 二季度业绩如下： 销售收入为 30.06 亿美元，环比增长 20.0%。

	毛利率为 25.3%，环比增长 5.2 个百分点。 经营利润为 5.34 亿美元。 息税折旧及摊销前利润为 21.09 亿美元。息税折旧及摊销前利润率为 70.2%。 归属于本公司的应占利润为 4.79 亿美元 关于资产负债，在二季度末： 公司总资产为 572 亿美元，其中库存资金 139 亿美元。 总负债为 193 亿美元，其中，有息负债为 140 亿美元。 总权益为 379 亿美元。 有息债务权益比为 37.0%，净债务权益比为 0.4%。 关于现金流量，在二季度： 经营活动所得现金净额为 25.22 亿美元； 投资活动所用现金净额为 22.71 亿美元； 融资活动所得现金净额为 6.07 亿美元。 公司 2026 年上半年未经审核业绩如下： 销售收入为 55.11 亿美元，同比增长 23.7%。 毛利率为 22.9%，同比上升 1.5 个百分点。 经营利润为 7.82 亿美元。 息税折旧及摊销前利润为 35.45 亿美元，息税折旧及摊销前利润率为 64.3%。 归属于本公司的应占利润为 6.77 亿美元。 关于 2026 年三季度，我们的指引如下： 销售收入预计环比上升 2%到 4%，毛利率预计在 26%到 28%之间。 以上是公司财务方面的情况。 ▪ 联合首席执行官赵海军博士发言： 大家好，欢迎参加中芯国际 2026 年二季度业绩说明会。 二季度，公司晶圆量价齐升，单季收入突破三十亿美元，各项核心经营数据同比与环比实现了大幅增长。具体地说，公司整体实现销售收入 30.06 亿美元，环比增长 20.0%，其中，出货量环比增加了 14.4%，晶圆平均销售单价环比提升了 5.7%；出货量的增加主要源于人工智能对配套芯片的需求的激增与客户的提拉出货。公司新增 8 千片折合 12 英寸月产能；产能利用率为 93.7%，环比增长 0.6 个百分点。 销售收入以地区分类看，中国、美国、欧亚占比分别为 90%、8%和 2%，从金额看均有增加，其中中国区的增长幅度最大，达到 22%，主要因为人工智能配套芯片需求旺盛，海外订单回流，以及在地化制造继续加强。晶圆收入按尺寸分，十二英寸和八英寸占比分别为 78%和 22%；从
--	--

	金额上来看, 12 英寸晶圆收入环比增长 24%, 8 英寸晶圆收入环比增长 11%。 晶圆收入以应用来看, 智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车收入占比分别为 17%、16%、44%、7%、17%, 绝对值环比均有提升。公司将产能更多调配给需求紧缺的领域, 使得人工智能配套、电脑与平板、工业与汽车收入绝对值环比增长在四成左右。其他应用, 虽然终端整体下行, 但客户的提前拉货抵消了部分影响, 使得手机、消费、互联与可穿戴收入绝对值也实现了 8%、16%和 13%的成长。 二季度公司毛利率为 25.3%, 环比增加 5.2 个百分点, 主要原因为平均销售单价上升与产能利用率好于预期, 抵消了折旧增加对毛利率的拖累。从息税折旧及摊销前利润率来看, 环比提升了近 13 个百分点, 达到了 70%。 根据一、二季度未经审核的财务数据, 公司上半年销售收入超 55 亿美元, 较去年同期增长 23.7%; 毛利率为 22.9%, 较去年同期提升了 1.5 个百分点; 上半年公司资本开支合计 34 亿美元。 三季度, 公司预计出货量继续增长, 价格保持稳健, 收入指引为环比增长 2%到 4%; 毛利率指引为 26%-28%, 在抵消三季度新增折旧和暑期电力高峰后环比继续提高, 计入新增产能后的产能利用率预计维持在 95%左右高位, 有效摊薄了单位固定成本。 展望下半年, 人工智能产生的产业推动与溢出效应还将继续, 为集成电路制造带来广泛的需求。公司灵活调配已有产能, 快速验证新增产能, 帮助缓解产业链紧缺局面。同时我们也看到, 供应链成本上升的压力已经向制造环节传导, 公司将积极应对、克服困难, 努力将影响降至最低。总体来说, 我们对行业走向和公司发展保持乐观看法。 最后, 我们依然要感谢客户、供应商、投资者, 以及社会各界对公司的理解和大力支持。谢谢大家。 ■ 问答环节: 问题 1: 公司二季度出货量很强, 在产能增长 1.7%、产能利用率小幅度提升的情况下, 请问 14.4%的出货增量来自哪些领域? 主因是新厂贡献, 还是在产品产成品的库存释放? 从应用角度看, 增速较快的工业与汽车和电脑平板领域, 是不是有很大一部分来自 AI 配套芯片? 回复: 公司二季度营业额的增长主要来自于出货增加和价格上涨, 其中出货量增加了 14.4%, 一方面原因为客户需求强劲、提拉出货, 希望拿货越快越好、越多越好, 所以公司在二季度一方面加速生产出货的部分, 新投片的环节则缓一些。另一方面, 公司持续建设新的产能并一直在验
--	---

	证。前几年公司在各个厂区投资的产能现在也在客户的需求下上量了，所以有一部分是净增量，也叠加到了出货中。 你问到应用分类中工业与汽车和电脑平板的相关营业收入大概有四成左右的增长，大概有多少来自人工智能和人工智能配套。我们的定期报告非常严谨，客户在订单沟通中虽会注明芯片用途，但基于原本的分类尚无法体现该领域的全貌。但实际上我们能感受到客户对人工智能配套芯片的需求是巨大的，公司也在为相关客户加大拉货力度，整体出货量增长预估可达四成左右。 问题 2：公司对三季度销售收入指引是增长 2-4%，毛利率指引为 26%-28%，还在继续往上走。刚刚您提到，二季度有提前发货的影响，三季度出货量是否会相对来说比较平稳一点？我们应该怎么理解三季度和二季度销售收入增速明显变化的原因？ 回复：我们的销售收入来自于晶圆出货量和在晶圆下线时和客户定的价格。我们在二季度的出货，有很多是一季度甚至是去年第四季度下线的，这个时候还是旧有的价钱，新的订单、新的下线会使用新的价格。中芯国际的产能基本是在匀速爬坡增加的，也不是一下能释放出很多产能。二季度我们满足客户需求提拉出货，为了保障产线的健康运营，三季度就没有更多的提拉了。 问题 3：今年以来代工大概提了几次价格，每次大概提价的幅度如何？目前这个涨价是针对部分产品还是比较全面的，今年下半年到明年是否还有进一步提价的空间？二季度里面的价格增长中，单纯提价的部分和产品组合结构变化的部分的影响分别有多少？ 回复：中芯国际的涨价策略并非采取统一发函、自某时起全面调价的简单方式，而是根据客户及细分赛道的差异来和客户协商确定。这源于中芯国际的特殊性，公司覆盖的细分市场和客户类型多元，不同领域的供需状况差异显著。在产能紧张、供不应求且公司已集中资源实现突破的优势领域，我们会较早与客户启动价格协商。而今年手机、汽车和工业等市场实际处于下行状态，客户普遍承压，我们便未在这些领域推动涨价，或者要推迟到以后再做。二季度，如果剔除折旧增加的影响，毛利率环比上升 9-10 个百分点，也是主要得益于一季度谈价的释放。接下来，我们仍将在满载且供不应求的产能部分与客户协商价格，首要任务是优先支持最紧缺的环节，同时向业界看齐，在该类产品同行已涨价的情况下争取合理价格定位。 问题 4：公司现在在哪些细分的应用需求上，边际上变得更加紧张了？哪些应用可以给公司带来更高的附加价值？ 回复：中芯国际的价格走向与供需关系紧密相连。在供不应求的领域，尤其是公司长期深耕、技术和质量具备有竞争力的部分，价格是会上行的。
--	---

	当前，最紧张的细分市场集中在与算力相关的配套芯片上，包括数据中心和算力板中使用的逻辑电路、BCD 等，这些领域需求持续扩大。从外部数据看，全球 AI 投资规模仍在提升，国内外的互联网公司也大幅增加了硬件投资，这些都超出了原有预期。因此，AI 直接相关的配套芯片供不应求将是长期趋势。同时，由于人工智能配套芯片需求的增加，也产生了挤压效应。例如存储器公司不再生产低密度专用存储（如 NOR Flash、NAND Flash），导致这类产品的产能同样无法满足需求，价格随之持续上涨。此外，需求回流趋势也带来了一些影响，产能紧张正在向其他领域蔓延。手机芯片、大屏电视和中屏显示器所用的显示驱动芯片等领域客户现在已难以获得足够产能，开始主动协商未来的产能和价格布局。 问题 5：公司的产能利用率的提高和高景气是不是可以持续？能否帮我们把电源管理、MCU、CIS、显示驱动、还有模拟，这几个成熟制程归类到供不应求、供需平衡，还是在去库存这么几个状况里面？另外在需求端，我们看到工业和车规的占比是有一定提升的，是不是该领域终端已经由补库存开始转为复苏了？ 回复：整体来看，当前半导体行业的热度分化明显，供不应求的领域主要集中于人工智能、算力、数据中心和边缘计算相关的逻辑电路，以及各类板卡中的电源管理芯片。无论是 GPU、CPU，还是 HBM 内存、DRAM、SSD 固态硬盘和驱动、冷却电机驱动、光模块等，都离不开电源管理器件，需求量极为可观。以一个配备 72 个 GPU 的机柜为例，仅电源供应、电源管理就需约 16,000 个，因此这些领域整体处于供不应求状态。 随着整体产能趋紧，市场开始担心，若明年手机和消费类需求（电视、显示器、电脑等）回暖，当前库存难以支撑，叠加对来年涨价（包括晶圆、封测、封装材料等供应链各环节）的预期，下游客户正寻求平衡点，倾向于现在适当备货，以避免来年拿不到产能或承担更高成本。因此，我们已经明显看到备货回流的趋势，客户正在与公司协商今年年底及明年的产能分配方案。 你提到的，关于公司工业和汽车类营收占比的提升，是由于部分客户的产品可同时供应汽车、工业、手机、面板等多个领域。近期这些客户把产品更多的用于汽车和工业方向，所以财报中呈现的比值增加了。 问题 6：不同下游的需求不太一样，公司在消费、工业，还有包括车规，以及人工智能的相关的客户之间主要按照什么原则来分配产能？如果剔除了产品组合之后，不同类别的工艺的价格环比升降大概是多少？以及三季度所有价格的增量都已经谈完了，还有没兑现的部分？ 回复：在产能分配上，中芯国际优先遵循长期战略合作原则。过去已与客户形成战略绑定和共识，并据此承诺了产能建设，我们会优先保障这些客户的供应。在定价权方面，对于公司已具备竞争优势、达到业界第一梯队水平且供不应求的产品，如果其晶圆价格与同行仍有较大差距，我们具备充分的议价基础，会与客户协商，要求获得与质量和技术水平
--	---

	相匹配的合理价格认可。而对于其他领域，包括消费类和手机类，中芯国际致力于做到业界最好水准，但价格将随行业整体走势而定，不会在下行期主动减产或提价。公司将产品按分成八到十个平台、应用场景划分为五大类。不同赛道的景气度和客户诉求各异，有的重产能和技术支持，客户对价格不敏感；有的需共渡成本难关，因此我们要分开来看。价格的事情还是看整个行业的走势。行业涨价潮启动较早，公司在今年二、三月份已按趋势与客户进行过一轮协商，但仅限于部分产品，并非全面调价。具体的之前已经回答过。 问题 7：公司二季度 EBITDA 利润率是超过了 70%，纵向与公司历史及横向与全球各晶圆厂对比，都是非常优秀的水平。公司也预计三季度的毛利率继续提升，在折旧占比可能还会保持在一个比较高位的情况下，公司对于 EBITDA 利润率的指标，后续如何展望？ 回复：公司已给出三季度指引，且订单已接收到第四季度及年底，基于现有信息，今年内我们不会降价。除了毛利率和本年利润之外，EBITDA 还受到其他收益的影响，其中二季度体现了一部分一次性收益。进入三季度，来自联营公司及金融资产公允价值变动的收益存在不确定性，这会对三季度 EBITDA 产生一定影响。因此在折旧持续增加，Q3 毛利率指引仍有提升，产能利用率维持高位、平均销售单价保持现有态势的情况下，剔除一次性收益的影响，公司 EBITDA 整体仍有望维持高位并保持向好趋势。 问题 8：26 年的折旧同比增长超过 30%，但公司三季度毛利率指引还是非常好的一个提升态势。具体来看，比如说涨价，产品结构优化等，哪方面因素的贡献占比比较高呢？ 回复：涨价因素的影响大于产品结构优化带来的效果。产品结构优化确实具备一定的灵活性，但并非简单地将产能从低单价客户转向高单价客户。我们的产品结构优化主要体现为，当某一领域客户需求减少时，我们会将富余产能调配到当前客户更急需、价格也更高的产品上。例如，适当减少逻辑电路的产能，转而生产微控制器 MCU、特殊存储，或是将原本用于 LCD driver 的产能调整至 NOR FLASH 等。此外，公司新增的产能均是按照客户的需求来规划的，客户已明确来年的产能需求，中芯国际据此进行投资扩产。因此，新产能可以快速上量满载，产品均为质好价优的品类，这本身就构成了我们的一大竞争优势。 问题 9：公司对折旧的情况是怎么看，半年预期折旧的具体金额是多少，折旧什么时候会达到一个峰值或者拐点？ 回复：我们在此前业绩发布会上已说明，今年全年折旧预计同比增长约三成。今年上半年折旧约为 23 亿美元，全年总额预计接近 50 亿美元，与此前预期基本一致。关于折旧何时达到峰值，如果根据之前的项目计划，2027 年预计将是折旧的高峰，但是实际未来什么时候达到峰值，是根据扩产计划逐步调整，具有不确定性。
--	--

	问题 10：公司发布了亮眼财报的同时，国内几大模拟的龙头也呈现出了非常好的业绩表现。目前我们看到 BCD 平台的供需状况和价格变化与其他环节存在较显著的景气度差异，想请教这种差异背后的原因是什么？很多模拟公司强调自身具备较深的工艺积累，甚至提出“虚拟 IDM”的概念。请问，不同模拟公司在产品切换方面的灵活性如何？它们之间在工艺能力上的差异具体有多大？ 回复：当前我们看到一个显著的结构性的变化，由人工智能带动，首先推动的是产业的两头，一头是先进算力和标准逻辑相关的制程，另一头则是非常成熟的模拟电路，尤其是 8 英寸的需求增长幅度远超预期。 模拟电路品类极为繁杂，需要长期积累和精细经营，没有任何一家公司能够覆盖全部型号。以海外巨头为例，其模拟电路型号高达二三十万种。其中，单一需求量较大的型号可以快速上量，甚至转向 12 英寸生产；但仍有数千种产品需求量较小，且需保证未来十年持续供应，无法短时间内切换产线。目前可见的需求至少能延续至来年年底，因为每一座新建数据中心、每一片 GPU 或算力 ASIC，都必然需要相应的配套芯片，这一配套趋势是确定且持续的。因此，BCD 平台的需求和价格走势一直坚挺，整体处于供不应求状态。 不同模拟公司之间的差异主要体现在两个方面：一是电压能力。高压，尤其是 48 伏产品能提供的厂商较少，且可靠性验证周期长，这需要长期的技术积累和验证。二是客户关系的深度与延续性。那些与大客户建立了十多年稳定合作关系的公司，在客户需求爆发时能够迅速响应、快速上量；而如果客户现在才开始转移供应商，则节奏会明显滞后。因此我们主要是看这两点就好。 如需了解完整版业绩说明会，请在业绩发布一年内访问中芯国际官网收听完整版语音记录。
是否涉及应当披露重大信息的说明	沟通内容基于公司已公开披露信息。